

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月19日(19.06.2025)



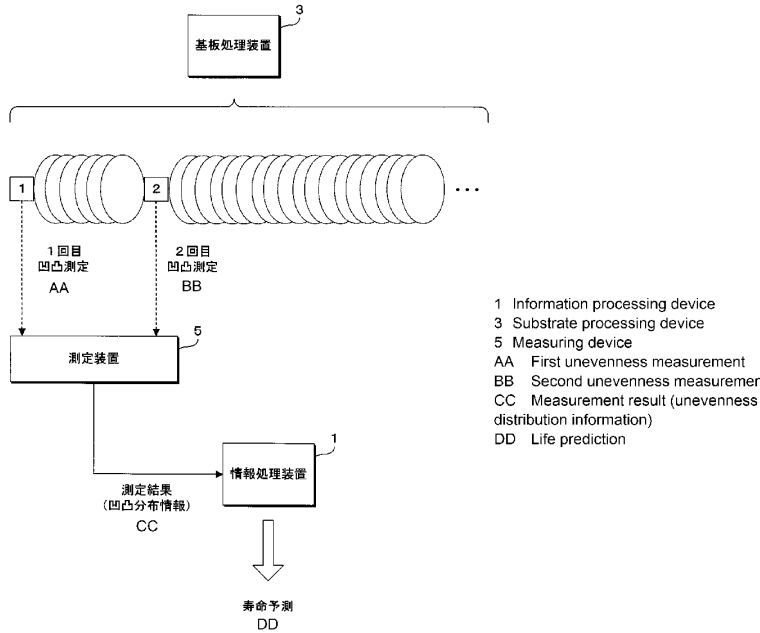
(10) 国際公開番号

WO 2025/127100 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *H05H 1/00* (2006.01)
G01B 11/30 (2006.01) *H05H 1/46* (2006.01)
H01L 21/3065 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/043978
- (22) 国際出願日: 2024年12月12日(12.12.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-212459 2023年12月15日(15.12.2023) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).
- (72) 発明者: 諏訪 亘(SUWA, Wataru); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 河野 英仁, 外(KOHNO, Hideto et al.); 〒5400035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目4番3号 河野特許事務所 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) Title: INFORMATION PROCESSING METHOD, COMPUTER PROGRAM, INFORMATION PROCESSING DEVICE, AND SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM

(54) 発明の名称: 情報処理方法、コンピュータプログラム、情報処理装置及び基板処理システム



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide an information processing method, a computer program, an information processing device, and a substrate processing system that can be expected to predict a state of an in-chamber component of a substrate processing device. In an information processing method according to the present embodiment, an information processing device acquires distribution information of unevenness of a surface of an in-chamber

[続葉有]

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

component of a substrate processing device at a first time point, acquires distribution information of unevenness of the in-chamber component at a second time point after the substrate processing is performed from the first time point, and predicts distribution information of unevenness of the in-chamber component at a time point after the substrate processing is performed from the second time point on the basis of the acquired distribution information of the first time point and the distribution information of the second time point.

(57) 要約: 基板処理装置のチャンバ内部品の状態を予測することが期待できる情報処理方法、コンピュータプログラム、情報処理装置及び基板処理システムを提供する。本実施の形態に係る情報処理方法は、情報処理装置が、第1時点における基板処理装置のチャンバ内部品の表面の凹凸の分布情報を取得し、前記第1時点から基板処理が行われた後の第2時点における前記チャンバ内部品の凹凸の分布情報を取得し、取得した前記第1時点の分布情報及び前記第2時点の分布情報を基に、前記第2時点から基板処理が行われた後の時点における前記チャンバ内部品の凹凸の分布情報を予測する。